

第5回次世代材料技術セミナー



マルチマテリアル化と接合技術

接着・溶接



■開催日時

3月23日(木)

13:30~16:40

■開催方式

オンライン

(Zoomウェビナー)

■参加費

無料

■対象

県内に事業所を有する企業

■定員

100名(事前申込制)

マルチマテリアル化に資するBlue-IRハイブリッドレーザ溶接技術や接着技術に関する実践的最新技術及び開発事例を紹介するとともに、最新の業界動向や接合材料の適材適所等について解説します。

御社の次世代ものづくりや新たな研究開発の取組にぜひ、本セミナーをご活用ください。

液状高耐熱樹脂の開発

～ 電子部品分野等への展開 ～

コニシ株式会社が開発した液状高耐熱樹脂は、硬化後にTg250°C以上の高耐熱性を持ちながら常温では液状のユニークな特徴を持っています。

この特徴を活かし、近年高性能化に伴い耐熱要求性能が上がると予想される電子部品への展開等について紹介します。

コニシ株式会社 研究開発本部 材料科学研究所長 森 茂樹 氏



コニシ株式会社
森 茂樹 氏

最新のレーザ溶接技術

～ 基礎と最新動向 ～

レーザ溶接の基礎として、レーザ誘起プルーム挙動とその影響、レーザ吸収機構と波長の影響、キーホール挙動と溶融池内湯流れ、気泡・ポロシティの発生機構と防止法、スパッタの発生機構などについて、溶接現象の高速ビデオ観察とX線透視観察法からの解明結果を紹介します。続いて、最新動向として、2重コアファイバ利用によるスパッタ低減効果や純銅のレーザ溶接結果、イン・プロセス・モニタリング結果、レーザ異材接合結果等を紹介いたします。

大阪大学 名誉教授・工学博士 片山 聖二 氏

株式会社ナ・デックス 技術統括フェロー

株式会社ナ・デックスプロダクツ ナ・デックスレーザR&Dセンター長



大阪大学 名誉教授
片山 聖二 氏

①～③より、御都合の良い方法でお申し込みください。

申込締切 令和5年3月22日(水)

①	NICOホームページ 申込フォーム	お申込みページに必要事項を御記入ください。 QRコードまたは下記URLよりお申込みページにアクセスしていただけます。 URL https://www.nico.or.jp/sien/seminar/63058/	
②	電子メール	必要事項をメール本文に御記載いただくか、本書をスキャナでpdfデータ化したものをメールに添付してお送りください。 宛先: challenge2@nico.or.jp	
③	FAX	必要事項を御記入の上、下記までお送りください。 宛先: 025-246-0030	

<必要事項>

事業者名		
連絡先		
TEL.	FAX.	
所属・役職名:	氏名:	E-mail:
所属・役職名:	氏名:	E-mail:
所属・役職名:	氏名:	E-mail:

※御記入いただいた個人情報は、本研究会事業等の案内のみに利用し、それ以外の目的には使用しません。

■開催方式

- ・オンラインセミナーは「Zoomウェビナー」を使用して開催します。
セミナー前日までに、ご登録いただいたEメールアドレス宛てに招待メールを送付します。招待メール中にあるリンクからウェビナーにご参加ください。
- ・当日13:00～13:15にウェビナーへの接続テストを行います。
時間になりましたら、招待メール記載の内容に従ってご参加ください。
- ・セミナーの録画、録音、撮影等は禁止します。

■プログラム

令和5年3月23日(木)

13:30 - 14:50 「液状高耐熱樹脂の開発 ～ 電子部品分野への展開～」
コニシ株式会社 研究開発本部 材料科学研究所長
森 茂樹 氏

14:50 - 15:00 質疑応答

15:00 - 15:10 休憩

15:10 - 16:30 「最新のレーザ溶接技術 ～ 基礎と最新動向～」
大阪大学 名誉教授

株式会社ナ・デックス技術統括フェロー
株式会社ナ・デックスプロダクツ ナ・デックス レーザR&Dセンター長
片山 聖二 氏

16:30 - 16:40 質疑応答